

# SMコンタクト

SM contact

## SM-485030-I



- 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating..... 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... 高さ =2.1 ~ 4.8mm Height: 2.1 mm to 4.8 mm

### 用 途

### Applications

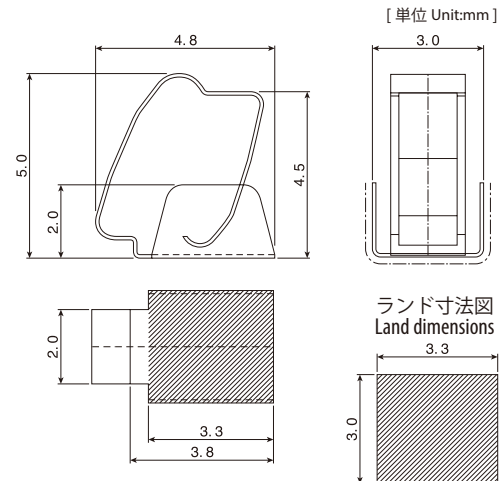
- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。  
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

### 標準梱包数量

### Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	2,000ヶ (リール) 2,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	28,000ヶ (外箱) 28,000/box	14リール / 1箱 梱包 Fourteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。  
\* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



### 特 性

### Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件																					
初期抵抗値 Initial resistance	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。																					
圧縮荷重 Compressive load	0.5N ~ 1.2N 以下 0.5 N to 1.2 N	測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mm~2.7mmに圧縮した時の反発力を測定する。																					
		測定方法 製品を測定用基盤に半田付けし、製品高さを2.7mmに圧縮した時と4.7mmに圧縮した時の荷重をプッシュメータを使用し手作業で測定する。																					
測定結果		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>サンプル1</th> <th>サンプル2</th> <th>サンプル3</th> <th>サンプル4</th> <th>サンプル5</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.7mm 時</td> <td>0.6N</td> <td>0.6N</td> <td>0.5N</td> <td>0.5N</td> <td>0.6N</td> <td>0.56N</td> </tr> <tr> <td>2.7mm 時</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.1N</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.14N</td> </tr> </tbody> </table>		サンプル1	サンプル2	サンプル3	サンプル4	サンプル5	平均	4.7mm 時	0.6N	0.6N	0.5N	0.5N	0.6N	0.56N	2.7mm 時	1.2N	1.1N	1.1N	1.2N	1.1N	1.14N
	サンプル1	サンプル2	サンプル3	サンプル4	サンプル5	平均																	
4.7mm 時	0.6N	0.6N	0.5N	0.5N	0.6N	0.56N																	
2.7mm 時	1.2N	1.1N	1.1N	1.2N	1.1N	1.14N																	
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr																					
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95% RH 処理時間: 500hr																					
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr																					
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル																					
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30% 以下 30% or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペース高さ																					
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。 半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec.																					